

関係各位

レンゴー株式会社
広報部広報課

「エコプロ 2019」出展のご案内

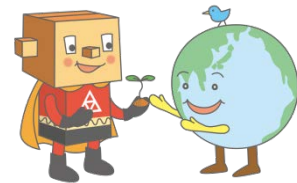
レンゴー株式会社（本社：大阪市北区、会長兼社長：大坪 清）は、今年も「エコプロ 2019 持続可能な社会の実現に向けて」に出展いたします。

当社ブースでは「段ボール Lab」をテーマに、より少ない資源で大きな価値を生む、当社の製品づくりのキーワード“Less is more.”を体現するパッケージのかずかずをご紹介します。

是非ご来場のうえ、当社ブースへお立ち寄りいただきますようご案内申し上げます。

エコプロ 2019 概要

会 期 2019年12月5日（木）～7日（土）10:00～17:00
会 場 東京ビッグサイト（東京国際展示場）
主 催 一般社団法人産業環境管理協会、日本経済新聞社
当社ブース 西2ホール 2-001



レンゴーブースの主な展示内容

- ・ 段ボールの優れた特徴とリサイクルの仕組み
- ・ 生分解性素材であるセルロース関連製品
- ・ 開封が容易で店頭での品出し作業を効率化するリテールメイトシリーズ「レンゴー スマート・ディスプレイ・パッケージング (RSDP)」
- ・ 耐水、防災など、さまざまな機能性段ボール
- ・ 段ボールベッドなどの防災関連製品



以上